

国家标准：GB/T 6618 《硅片厚度和总厚度变化测试方法》

产品名称	国家标准：GB/T 6618 《硅片厚度和总厚度变化测试方法》
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二 单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

标准号 Standard No.	中文标准名称 Standard Title in Chinese	英文标准名称 Standard Title in English	状态 State	备注
GB/T 6618-1995	硅片厚度和总厚度变化测试方法	Test method for thickness and total thickness variation of silicon slices	废止	1995-8-198 B/T 6
GB/T 6618-2009	硅片厚度和总厚度变化测试方法	Test method for thickness and total thickness variation of silicon slices	现行	2010-6618-

本标准规定了硅单晶切割片、研磨片、抛光片和外延片(简称硅片)厚度和总厚度变化的分立式和扫描式测量方法。本标准适用于符合GB/T 12964、GB/T 12965、GB/T 14139规定的尺寸的硅片的厚度和总厚度变化的测量。在测试仪器允许的情况下，本标准也可用于其他规格硅片的厚度和总厚度变化的测量。

[标准全文查看/下载](#)

<http://c.gb688.cn/bzgk/gb/showGb?type=online&hcno=99F6C48C8721C6057415BC57F11B2941>